|  |
| --- |
| [中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业现状分析与发展前景研究报告（2025年版）](https://www.20087.com/M_ShiYouHuaGong/69/BanDaoTiYongHuanYangSuFengLiaoEMCDeFaZhanQianJing.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业现状分析与发展前景研究报告（2025年版）](https://www.20087.com/M_ShiYouHuaGong/69/BanDaoTiYongHuanYangSuFengLiaoEMCDeFaZhanQianJing.html) |
| 报告编号： | 1586169　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：8200 元　　纸介＋电子版：8500 元 |
| 优惠价： | 电子版：7360 元　　纸介＋电子版：7660 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/M_ShiYouHuaGong/69/BanDaoTiYongHuanYangSuFengLiaoEMCDeFaZhanQianJing.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　半导体用环氧塑封料（EMC）是半导体封装材料的重要组成部分，广泛应用于集成电路芯片的封装过程中，以保护芯片免受外界环境影响，并提供必要的机械支撑。随着电子行业的发展，特别是5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起，EMC的市场需求持续增长。目前，EMC材料不断更新换代，以满足更高性能和更小型化芯片封装的需求。  
　　未来半导体用环氧塑封料的发展将更加注重性能提升和技术创新。一方面，随着芯片集成度的提高和封装技术的进步，EMC材料需要具备更高的热稳定性、更低的介电常数和更好的绝缘性能，以适应先进封装技术的要求。另一方面，随着可持续发展成为全球共识，EMC材料的开发将更加关注环保标准，如减少有害物质的使用，提高材料的可回收性和可再利用性。  
　　《[中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业现状分析与发展前景研究报告（2025年版）](https://www.20087.com/M_ShiYouHuaGong/69/BanDaoTiYongHuanYangSuFengLiaoEMCDeFaZhanQianJing.html)》基于科学的市场调研与数据分析，全面解析了半导体用环氧塑封料（EMC）行业的市场规模、市场需求及发展现状。报告深入探讨了半导体用环氧塑封料（EMC）产业链结构、细分市场特点及技术发展方向，并结合宏观经济环境与消费者需求变化，对半导体用环氧塑封料（EMC）行业前景与未来趋势进行了科学预测，揭示了潜在增长空间。通过对半导体用环氧塑封料（EMC）重点企业的深入研究，报告评估了主要品牌的市场竞争地位及行业集中度演变，为投资者、企业决策者及银行信贷部门提供了权威的市场洞察与决策支持，助力把握行业机遇，优化战略布局，实现可持续发展。  
  
第一章 环氧塑封料产品概述  
　　1.1 环氧塑封料产品定义  
　　1.2 环氧塑封料的发展历程与产业现况  
　　1.3 环氧塑封料技术发展趋势  
　　1.4 环氧塑封料在半导体产业中的重要地位  
  
第二章 环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程  
　　2.1 环氧塑封料产品组成  
　　2.2 环氧塑封料产品品种分类  
　　　　2.2.1 以分立器件封装和集成电路封装两类分类  
　　　　2.2.2 以EMC所采用的环氧树脂体系分类  
　　　　2.2.3 以芯片封装外形以及具体应用分类  
　　　　2.2.4 以EMC的不同性能分类  
　　2.3 环氧塑封料制作过程  
　　2.4 环氧塑封料产品性能  
　　　　2.4.1 未固化物理性能  
　　　　2.4.2 固化物理性能  
　　　　2.4.3 机械性能  
  
第三章 环氧塑封料的应用及其主要市场领域  
　　3.1 IC封装的塑封成形工艺过程  
　　　　3.1.1 IC封装塑封成形的工艺过程  
　　　　3.1.2 IC封装塑封成形的工艺要点  
　　　　3.1.3 IC封装塑封成形的质量保证  
　　3.2 环氧塑封料的应用领域  
　　　　3.2.1 分立器件封装  
　　　　3.2.2 集成电路封装  
  
第四章 全球半导体封测产业概况及市场分析  
　　4.1 世界半导体封装业发展特点  
　　4.2 世界半导体封装产品的主要生产制造商  
　　4.3 世界半导体封装业的发展现状  
　　　　4.3.12014 年世界半导体产业与市场概况  
　　　　4.3.2 世界封测产业与市场概况  
　　4.4 世界封测产业的发展总趋势  
　　4.5 世界封测生产值统计  
  
第五章 我国半导体封测产业概况及市场分析  
　　5.12014 年我国半导体产业发展状况  
　　5.2 我国集成电路封测业发展现况  
　　　　5.2.1 我国集成电路产业发展  
　　　　5.2.2 我国集成电路封测产业发展现况  
　　　　5.2.2 .1我国IC封测产业市场规模现状  
　　　　5.2.2 .2我国IC封测厂家分布及产能  
　　　　5.2.2 .3我国IC封测业的骨干生产企业情况  
　　　　5.2.2 .4我国IC封测业内资企业在近期的技术发展  
　　5.3 我国半导体分立器件封测业发展现况  
　　　　5.3.1 我国半导体分立器件生产现况  
　　　　5.3.2 我国半导体分立器件行业发展特点  
　　　　5.3.3 我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构  
　　　　5.3.4 我国半导体分立器件生产厂家情况  
　　　　5.3.5 我国半导体分立器件市场发展前景  
  
第六章 世界环氧塑封料产业的生产与技术现状  
　　6.1 世界环氧塑封料生产与市场总况  
　　6.2 世界环氧塑封料主要生产企业概述  
　　6.3 日本环氧塑封料生产厂家现状  
　　　　6.3.1 住友电木（SumitomoBakelite）  
　　　　6.3.2 日东电工（NittoDenko）  
　　　　6.3.3 日立化成（HitachiChemical）  
　　　　6.3.4 松下电工株式会社（MatsushitaElectric）  
　　　　6.3.5 信越化学工业（Shin-EtsuChemical）  
　　　　6.3.6 京瓷化学（KyoceraChemical）  
　　6.4 中国台湾环氧塑封料生产厂家现状  
　　　　6.4.1 长春人造树脂  
　　　　6.4.2 中国台湾其它环氧塑封料生产厂家现状  
　　6.5 韩国环氧塑封料生产厂家现状  
　　　　6.5.1 韩国环氧塑封料生产厂家情况总述  
　　　　6.5.2 三星集团第一毛织  
　　　　6.5.3 韩国KCC  
　　6.6 欧美塑封料生产厂家现状  
　　　　6.6.1 汉高集团（Hysol）  
　　　　6.6.2 欧美其它环氧塑封料生产厂家现状  
  
第七章 我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求  
　　7.1 我国环氧塑封料业的发展现状  
　　7.2 我国环氧塑封料业生产企业情况  
　　7.3 我国环氧塑封料业技术水平现况  
　　　　7.3.1 国内不同性质企业的EMC产品水平分析  
　　　　7.3.2 国内不同性质企业的EMC技术与产品结构现况  
　　　　7.3.3 国内不同性质企业在EMC产品与技术研发能力的现况  
　　7.4 我国国内环氧塑封料的市场需求情况  
　　7.5 未来几年我国环氧塑封料行业的发展趋势预测  
　　7.6 我国环氧塑封料的主要生产厂家情况  
　　　　7.6.1 汉高华威电子有限公司  
　　　　7.6.2 长兴电子材料（昆山）有限公司  
　　　　7.6.3 住友电木（苏州）有限公司  
　　　　7.6.4 日立化成工业（苏州）有限公司  
　　　　7.6.5 北京首科化微电子有限公司  
　　　　7.6.6 佛山市亿通电子有限公司  
　　　　7.6.7 浙江恒耀电子材料有限公司  
　　　　7.6.8 江苏中鹏电子有限公司  
　　　　7.6.9 江苏晶科电子材料有限公司  
　　　　7.6.10 广州市华塑电子有限公司  
　　　　7.6.11 松下电工（上海）电子材料有限公司  
　　　　7.6.12 北京中新泰合电子材料科技有限公司  
　　　　7.6.13 长春封塑料（常熟）有限公司  
　　　　7.6.14 无锡创达电子有限公司  
　　　　7.6.15 广东榕泰实业股份有限公司  
  
第八章 中^智林^－环氧塑封料生产主要原材料及其需求  
　　8.1 EMC用环氧树脂  
　　　　8.1.1 EMC对环氧树脂原料的要求  
　　　　8.1.2 世界及我国环氧树脂业发展现状  
　　　　8.1.3 国内环氧树脂产业的原材料供应情况  
　　　　8.1.3 .1双酚A  
　　　　8.1.3 .2环氧氯丙烷（ECH）  
　　　　8.1.4 绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况  
　　8.2 EMC用硅微粉  
　　　　8.2.1 EMC对硅微粉原料的要求  
　　　　8.2.2 EMC用硅微粉产品概述  
　　　　8.2.3 国外EMC用硅微粉产品生产的现况  
　　　　8.2.3 .1日本EMC用硅微粉的生产现况  
　　　　8.2.3 .2北美EMC用硅微粉的生产现况  
　　　　8.2.3 .3欧洲EMC用硅微粉的生产现况  
　　　　8.2.4 国内EMC用硅微粉产品生产的现况  
　　图表 报告：  
  
图表目录  
　　图表 1：2025年中国GDP  
　　图表 2：2025-2031年国内生产总值及其增长速度  
　　图表 3：2025年居民消费价格月度涨跌幅度  
　　图表 4：2025年居民消费价格比上年涨跌幅度  
　　图表 5：2025年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比  
　　图表 6：2025-2031年全部工业增加值及其增长速度  
　　图表 7：2025年主要工业产品产量及其增长速度  
　　图表 8：2025-2031年全国一般公共财政收入  
　　图表 9：2025-2031年全年社会消费品零售总额  
　　图表 10：2025-2031年货物进出口总额  
　　图表 11：2025年货物进出口总额及其增长速度  
　　图表 12：2025年主要商品出口数量、金额及其增长速度  
　　图表 13：2025年主要商品进口数量、金额及其增长速度  
　　图表 14：2025年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度  
　　图表 15：2025年中国固定资产投资  
　　图表 16：2025-2031年全社会固定资产投资  
　　图表 17：2025年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度  
　　图表 18：2025年固定资产投资新增主要生产与运营能力  
　　图表 19：环氧塑封料产品组成  
　　图表 20：IC封装塑封成形的工艺过程  
　　图表 21：封装技术应用领域及代表性封装型式  
　　图表 22：2025-2031年全球半导体封测产值分析  
　　图表 23：2025-2031年我国集成电路行业增长情况  
　　图表 24：2025年我国集成电路出口情况  
　　图表 25：2025年集成电路产业内销产值增长情况  
　　图表 26：2025-2031年我国集成电路固定资产投资增长情况  
　　图表 27：2025年我国集成电路行业经济效益增长情况  
　　图表 28：国内IC封装测试业销售收入统计表  
　　图表 29：2025年中国集成电路产业三业占比情况  
　　图表 30：国内IC封装测试业销售收入统计  
　　图表 31：2025年全国半导体分立器件产量分省市统计表  
　　……  
　　图表 33：2025-2031年我国环氧塑封料需求量  
　　图表 34：各种结构的树脂对环氧模塑料性能的影响  
　　图表 35：2025年国内BPA市场走势图  
　　图表 36：2025-2031年BPA进口及均价图  
　　图表 37：上半年亚太地区主要双酚A装置检修统计表  
　　图表 38：2025-2031年主要进口来源对比  
　　图表 39：2025年国内新增苯酚丙酮产能统计表  
　　图表 40：下半年双酚A原料市场价格波动表  
　　图表 41：2025-2031年来自韩国BPA进口统计  
　　图表 42：燃烧过程示意图：  
　　图表 43：各种阻燃剂及其阻燃机理  
　　图表 44：各种阻燃剂性能比较  
　　图表 45：阻燃剂类型  
　　图表 46：几种无卤型阻燃剂对环氧塑封料性能影响比较  
　　图表 47：绿色环氧塑封料性能改进  
略……

了解《[中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业现状分析与发展前景研究报告（2025年版）](https://www.20087.com/M_ShiYouHuaGong/69/BanDaoTiYongHuanYangSuFengLiaoEMCDeFaZhanQianJing.html)》，报告编号：1586169，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：[Kf@20087.com](mailto:Kf@20087.com)

详细介绍：<https://www.20087.com/M_ShiYouHuaGong/69/BanDaoTiYongHuanYangSuFengLiaoEMCDeFaZhanQianJing.html>

热点：半导体封装材料树脂、半导体封装用环氧树脂、emc环氧塑封料成型工艺、半导体塑封料对人体危害、半导体molding工艺、半导体封装塑封料、集成电路塑封工艺、半导体环氧树脂

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！